

晶粒(Dice)產品包裝標籤變更說明

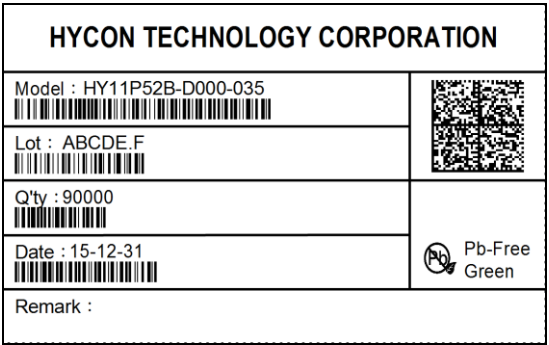
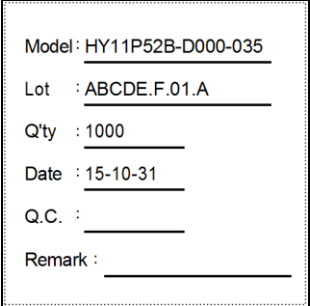

一、主旨：標籤變更原因

為了增加產品流向管理與清查之便利性，及改善標籤的辨識度，紘康科技變更標籤格式，並且於標籤中加入一維、二維條碼，以利客戶做先進先出(FIFO)管制之輸入依據。

二、說明：標籤變更說明及識別方式

1. 現有外包裝袋標籤有紘康 LOGO 圖樣: **HYCON**，更改後標籤上直接列印公司名稱「**HYCON TECHNOLOGY CORPORATION**」，並加入一維、二維條碼。
2. 現有晶粒盤上蓋標籤無二維條碼，更改後加入二維條碼。

實例說明如下：

	原標籤	更改後標籤
外包裝袋 標籤	 <p>Model : <u>HY11P52B-D000-035</u> Packing : <u>Tray in Vac</u> Lot No : <u>ABCDE.F</u> D/C : _____ Q'TY : <u>90000</u> Date : <u>2015/12/31</u> Remark : _____</p>	 <p>HYCON TECHNOLOGY CORPORATION</p> <p>Model : <u>HY11P52B-D000-035</u> Lot : <u>ABCDE.F</u> Q'ty : <u>90000</u> Date : <u>15-12-31</u> Remark : _____</p> <p> Pb-Free Green</p>
晶粒盤 上蓋標籤	 <p>Model : <u>HY11P52B-D000-035</u> Lot : <u>ABCDE.F.01.A</u> Q'ty : <u>1000</u> Date : <u>15-10-31</u> Q.C. : _____ Remark : _____</p>	 <p>Model : <u>HY11P52B-D000-035</u> Lot : <u>ABCDE.F.01.A</u> Q'ty : <u>1000</u> Date : <u>15-10-31</u> Q.C. : _____ Remark : _____</p> <p></p>

3. 客戶下單時，請仍然依照 **Data Sheet** 訂貨資訊內容訂購，此標籤變更不影響產品規格及功能。
4. 本公司由 2015 年 Q4 起，開始更新標籤格式，未來會有一段時間兩種格式的標籤會並存，上述兩種標籤皆為本公司標準標籤，請客戶放心使用。

三、補充說明：

上述變更，如有任何問題，麻煩請不吝儘速，透過代理商與我們溝通。

紘康科技股份有限公司 品保處 2015-12-16